
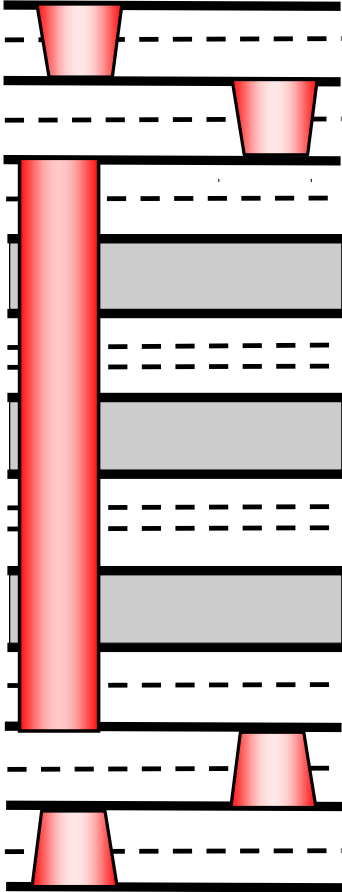


LAGENAUFBAU HDI (Standard)														
HDI12_2+8b+2_1,55_35			12 - Lagen							Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm				
WE-Artikel Nr.:		2 + 8B + 2												
KUNDE:														
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG					
KUNDE	WE							[µm]	[µm]					
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12						
									1 x 1080	60				
2	VSK2				Folie	12 µm		30						
									1 x 1080	60				
3	VSK1				Folie	9 µm		30						
									1 x 1080	60				
4	2					35 µm		33						
					0,20 mm			200						
5	3					35 µm		33						
									2 x 1080	124				
6	4					35 µm		33						
		0,20 mm			200									
7	5		35 µm		33									
						2 x 1080	124							
8	6		35 µm		33									
		0,20 mm			200									
9	7		35 µm		33									
						1 x 1080	60							
10	RSK1		9 µm		30									
						1 x 1080	60							
11	RSK2	Folie	12 µm		30									
						1 x 1080	60							
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12									
1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm														
Gesamtdicke Material:								1550						
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)														
MATERIALDICKE:		1,55	+/-	0,13	mm	Datum:		Bearbeiter:						
DICKE über galv. Endoberfläche		1,64	+/-	0,16	mm									
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,70	+/-	0,18	mm									
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:								
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am						
29.03.2006		S.Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006						
								Revision						
								00						
								Seite: 17+						